

# 導電性接合材

## Self Assembling Material

### チップやカメラモジュールの実装に! SAM10-401-27

#### Chip mounting for camera module

#### 特長

features

- 1) 低温大気リフロー (160°C / 4分) での合金接合と樹脂硬化が可能です。  
Alloy joint and resin stiffening can be achieved by using air reflow at low temperature (160°C/4min)
- 2) Pbフリー合金を使用しています。  
This product uses Pb free alloy.
- 3) 0603チップ実装に対応可能です。  
This product is possible to mount 0603chip.
- 4) ハロゲンフリーでVOCフリーの製品です。  
This product uses halogen-free and VOC-free.
- 5) 無洗浄でありながら、高い信頼性をもっています。  
High reliability without cleaning
- 6) 連続印刷時の粘度経時変化が少ない。  
A little viscosity change during continuous printing



| 項目<br>Items   |                            | SAM10-401-27                             | 試験方法<br>Test method                 |
|---|----------------------------|--|-------------------------------------|
| 合金粉末<br>Alloy powder  | 合金組成<br>Alloy composition  | Sn42/Bi58                                | JIS Z 3282 (1999)                   |
|   | 融点<br>Melting point        | 139°C                                    | DSC測定<br>DSC measurement            |
|   | 粒径<br>Particle size        | 10~34µm                                  | レーザー回折法<br>Laser diffraction method |
|   | 含有率<br>Solder powder ratio | 85.5%                                    | -                                   |
| フラックス<br>(樹脂含む)<br>Flux with resin                                    | 含有率<br>Flux ratio          | 14.5%                                    | JIS Z 3284                          |
| 粘度 (25°C)<br>Viscosity  | 250 Pa·s                   | JIS Z 3284 PCU<br>製粘度計 PCU<br>viscometer |                                     |
| チクソ指数<br>Thixotropy index   | 0.45                       |  |                                     |
| 連続印刷性 (回)<br>Continuous print   | 40                         | STD-006n                                 |                                     |
| ローリング試験 (h)<br>Rolling test   | 24                         | STD-170c                                 |                                     |
| ピンボール径/ピン長<br>Solder ball (the number of ball)                        | 0.3                        | STD-167                                  |                                     |
| チップ裏がール個/チップ<br>solder ball (the number of ball<br>(開口部 opening 100%) | 0.3                        | STD-168d                                 |                                     |
| ポットライフ (日)<br>Pot life days   | 180                        | -  |                                     |

